



Title of Change:	Update Notification to FPCN22191XM - SOIC-8 Project Before and After Change Description table updated	
Proposed first ship date:	16 April 2019	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <ramilangelo.nonato@onsemi.com >	
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Lalan.Ortega@onsemi.com>	
Type of notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Change Part Identification:	Product marked with date code 1812 or later may be built from current factory or from OSPI Factory. The trace code marking on Line 2 is of the form ALYW where A = Assembly Location, L = Wafer Lot ID and YW is a 2-digit date code. Product marked with "P" as the assembly location will be from OSPI. Additionally on the label of the box and reel, the ASSY LOC: PO will also indicate product assembled in OSPI. Please see sample label on Page 2 at the following URL http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LABELRM-D.PDF to see the location of the ASSY LOC.	
Change Category:	☐ Wafer Fab Change ☒ Assembly Change ☐ Test Change ☐ Other _____	
Change Sub-Category(s): ☒ Manufacturing Site Addition ☒ Material Change ☐ Datasheet/Product Doc change ☐ Manufacturing Site Transfer ☐ Product specific change ☒ Shipping/Packaging/Marking ☐ Manufacturing Process Change ☐ Other: _____		
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Carmona, Philippines	External Foundry/Subcon Sites: GEM, China
Description and Purpose: This Update Notification is issued to update the Before and After Change Table from FPCN22191XM FPCN. BOM changes associated with this FPCN are shown here:		
	Before Change Description	After Change Description
Lead frame	RPPF – HANA	RPPF – HANA & OSPI
	Ag spot Cu – GEM	RPPF (Ag spot Cu) – GEM & OSPI
Mold Compound	HITACHI CEL8240HF10LYR	Sumitomo G600F
Die Attach	Henkel QMI 519	Henkel ABP8062T
Wire size and Material	2 mil Cu	2 mil Cu (No change)
Reliability Data Summary: See original FPCN22191XM		

**Electrical Characteristic Summary:**

The temperature characterization meets datasheet specification. Electrical characteristics are not impacted. Detail of Electrical characterization result is available upon request.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
FDS2572	FDS2572
FDS2582	FDS2572
FDS2672	FDS2572
FDS3572	FDS2572
FDS3672	FDS2572
FDS3692	FDS2572
FDS3992	FDS2572
FDS5672	FDS2572
FDS2734	FDS2734

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22191XM1

発行日: 16 April 2019

変更件名:	FPCN22191XM の更新通知 — SOIC-8 プロジェクト変更前後の説明一覧表の更新	
初回出荷予定日:	16 April 2019	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または ramilangelo.nonato@onsemi.com にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または PCN.Samples@onsemi.com にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。	
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または Lalan.Ortega@onsemi.com にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、 PCN.Support@onsemi.com 宛てをお願いします。	
変更部品の識別:	日付コード 1812 以降の日付表示がある製品は、現在の工場または OSPI 工場で組み立てられていることとなります。2 行目に記載されているトレースコードは、フォーム ALYW (A は組み立て場所、L はウエハロット、ID および YW は 2 桁の日付コード) のものです。組み立て場所として「P」のマークがついている製品は OSPI からのものです。さらに、箱およびリールのラベルに ASSY LOC が記載されています。PO は OSPI で組み立てられた製品も示します。以下の URL にある 2 ページ目のサンプルラベルを参照してください http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LABELRM-D.PDF の ASSY LOC の場所を参照してください。	
変更カテゴリ:	☐ ウェハファブの変更 ☒ アセンブリの変更 ☐ 試験の変更 ☐ その他 _____	
変更サブカテゴリ:	☒ 製造拠点の追加 ☒ 材料の変更 ☐ データシート/製品資料の変更 ☐ 製造拠点の移転 ☐ 製品仕様の変更 ☒ 出荷/パッケージング/表記 ☐ 製造プロセスの変更 ☐ その他: _____	
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: ON Carmona, Philippines	外部製造工場 / 下請業者拠点: GEM, China
説明および目的: 本更新通知は FPCN22191XM FPCN の変更前後の説明一覧表の更新をお知らせするものです。 今回の FPCN に関連する BOM の変更を以下に示します。		
	変更前	変更後
リードフレーム	RPPF – HANA	RPPF – HANA & OSPI
	Ag spot Cu – GEM	RPPF (Ag spot Cu) – GEM & OSPI
モールド・コンパウンド	HITACHI CEL8240HF10LYR	Sumitomo G600F
ダイ接着剤	Henkel QMI 519	Henkel ABP8062T
ワイヤ径および材料	2 mil Cu	2 mil Cu (No change)
信頼性データの要約: オリジナルの FPCN22191XM を参照してください		

**電気的特性の要約:**

温度特性はデータシートの規格に適合します。電気的特性への影響はありません。電気的特性評価結果の詳細は、要求に応じて入手可能です。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ビークル
FDS2572	FDS2572
FDS2582	FDS2572
FDS2672	FDS2572
FDS3572	FDS2572
FDS3672	FDS2572
FDS3692	FDS2572
FDS3992	FDS2572
FDS5672	FDS2572
FDS2734	FDS2734